

**HiPerFET™ Power MOSFETs**  
**ISOPLUS247™**
**IXFR 100N25**

$$V_{DSS} = 250 \text{ V}$$

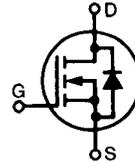
$$I_{D25} = 87 \text{ A}$$

$$R_{DS(on)} = 27 \text{ m}\Omega$$

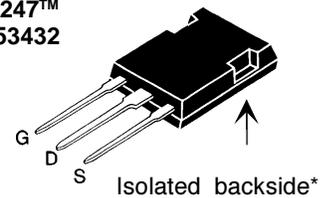
**(Electrically Isolated Backside)**

 N-Channel Enhancement Mode  
 Avalanche Rated, High dv/dt, Low  $t_{rr}$ 

$$t_{rr} \leq 250 \text{ ns}$$



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{DSS}$	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	250	V
$V_{DGR}$	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	250	V
$V_{GS}$	Continuous	$\pm 20$	V
$V_{GSM}$	Transient	$\pm 30$	V
$I_{D25}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$ (MOSFET chip capability)	87	A
$I_{L(RMS)}$	$T_C = \text{External lead current limit}$	75	A
$I_{DM}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$ , Note 1	400	A
$I_{AR}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	100	A
$E_{AR}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	64	mJ
$E_{AS}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	3	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$ , $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$ , $V_{DD} \leq V_{DSS}$ $T_J \leq 150^\circ\text{C}$ , $R_G = 2 \Omega$	5	V/ns
$P_D$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	400	W
$T_J$		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
$T_{JM}$		150	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
$T_L$	1.6 mm (0.063 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
$V_{ISOL}$	50/60 Hz, RMS $t = 1 \text{ min}$	2500	V~
Weight		5	g

**ISOPLUS 247™**  
**E153432**

 G = Gate      D = Drain  
 S = Source

\* Patent pending

**Features**

- Silicon chip on Direct-Copper-Bond substrate
  - High power dissipation
  - Isolated mounting surface
  - 2500V electrical isolation
- Low drain to tab capacitance (<30pF)
- Low  $R_{DS(on)}$  HDMOS™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Rated for Unclamped Inductive Load Switching (UIS)
- Fast intrinsic Rectifier

**Applications**

- DC-DC converters
- Battery chargers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- DC choppers
- AC motor control

**Advantages**

- Easy assembly
- Space savings
- High power density

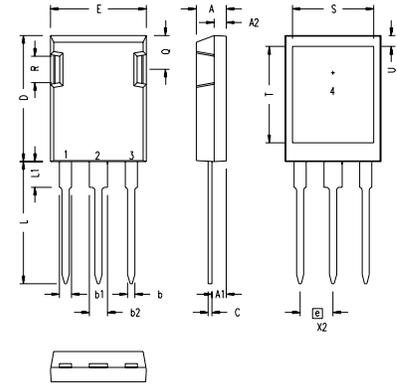
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$V_{DSS}$	$V_{GS} = 0 \text{ V}$ , $I_D = 3 \text{ mA}$	250		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$ , $I_D = 8 \text{ mA}$	2.0		4 V
$I_{GSS}$	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}$ , $V_{DS} = 0$			$\pm 200 \text{ nA}$
$I_{DSS}$	$V_{DS} = V_{DSS}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$		$T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$	100 $\mu\text{A}$ 2 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$ , $I_D = I_T$ Notes 2, 3			27 m $\Omega$

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)	Characteristic Values		
			min.	typ.	max.
$g_{fs}$	$V_{DS} = 10\text{ V}; I_D = I_T$	Notes 2, 3	40	70	S
$C_{iss}$	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$			9100	pF
$C_{oss}$				1800	pF
$C_{rss}$				600	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = I_T$ $R_G = 1\ \Omega$ (External), Notes 2, 3			42	ns
$t_r$				55	ns
$t_{d(off)}$				110	ns
$t_f$				40	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = I_T$ Notes 2, 3			300	nC
$Q_{gs}$				57	nC
$Q_{gd}$				160	nC
$R_{thJC}$				0.3	K/W
$R_{thCK}$			0.15		K/W

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)	Characteristic Values		
			min.	typ.	max.
$I_S$	$V_{GS} = 0\text{ V}$			100	A
$I_{SM}$	Repetitive; Note 1			400	A
$V_{SD}$	$I_F = I_T, V_{GS} = 0\text{ V}$ , Notes 2, 3			1.5	V
$t_{rr}$	$I_F = 50\text{ A}, -di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 100\text{ V}$			250	ns
$Q_{RM}$				1.4	$\mu\text{C}$
$I_{RM}$				10	A

Note: 1. Pulse width limited by  $T_{JM}$   
 2. Pulse test,  $t \leq 300\ \mu\text{s}$ , duty cycle  $d \leq 2\%$   
 3.  $I_T = 50$

### ISOPLUS 247 OUTLINE



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.190	.205	4.83	5.21
A1	.090	.100	2.29	2.54
A2	.075	.085	1.91	2.16
b	.045	.055	1.14	1.40
b1	.075	.084	1.91	2.13
b2	.115	.123	2.92	3.12
C	.024	.031	0.61	0.80
D	.819	.840	20.80	21.34
E	.620	.635	15.75	16.13
e	.215 BSC		5.45 BSC	
L	.780	.800	19.81	20.32
L1	.150	.170	3.81	4.32
Q	.220	.244	5.59	6.20
R	.170	.190	4.32	4.83
S	.520	.540	13.21	13.72
T	.620	.640	15.75	16.26
U	.065	.080	1.65	2.03

- 1 - GATE
- 2 - DRAIN (COLLECTOR)
- 3 - SOURCE (EMITTER)
- 4 - NO CONNECTION

NOTE: This drawing will meet all dimensions requirement of JEDEC outline TO-247AD except screw hole.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.